

深圳市深科达智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的
第二轮审核问询函中有关财务事项的回复

大华核字[2022]003307号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市深科达智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的
第二轮审核问询函中有关财务事项的回复

目 录

页 次

一、	向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函中有关财务事项的回复	2-42
----	--	------

深圳市深科达智能装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函中有关财务事项的回复

大华核字[2022]003307号

上海证券交易所：

由安信证券股份有限公司转来的《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）（2022）35号）奉悉。我们已对审核问询函所提及的和深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“深科达”或“发行人”）财务事项进行了审慎核查，现回复如下：

1.关于融资规模

根据申报材料，1）本次募集资金拟投入惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目11,766.50万元，半导体先进封装测试设备研发及生产项目8,925.59万元，平板显示器件自动化专用设备生产建设项目5,307.91万元。2）直接补充流动资金10,000.00万元。

请发行人说明：（1）上述各项目投资金额的具体构成，测算依据及测算过程，是否合理；（2）根据投资构成中非资本性支出的情况及《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第4问，补充流动资金比例是否超过募集资金总额的30%。

请申报会计师核查并发表意见。

回复：

一、上述各项目投资金额的具体构成，测算依据及测算过程，是否合理

（一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目

本项目拟投资 15,504.83 万元，其中拟使用募集资金投资 11,766.50 万元，具

体资金投入情况如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)	是否为资本性支出
1	场地投资	5,318.14	5,318.14	是
2	设备及软件投资	6,448.36	6,448.36	是
3	预备费	738.33	-	否
4	铺底流动资金	3,000.00	-	否
合计		15,504.83	11,766.50	/

惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目的投资金额具体构成、测算依据及测算过程如下：

1、场地投资

本项目场地投资主要为募投产品生产车间的建设及装修，场地总建筑面积为13,295.36平方米，场地投资总额为5,318.14万元，其中建设投资金额为2,393.16万元，装修费投资为2,924.98万元。场地总建筑面积主要是在现有可使用土地的基础上根据募投项目生产实际需要确定的；生产车间主要为钢结构和砖混结构，参考现有厂房的标准建设和装修，价格主要根据募投项目实施地当前物价水平确定，具体投资情况如下：

序号	项目	建筑面积 (m ²)	建设投资 (万元)	装修费 (万元)	单位造价 (元/m ²)
1	机加车间	4,000.00	720.00	680.00	3,500.00
2	装配车间	3,720.22	669.64	632.44	3,500.00
3	无尘调试车间	3,000.00	540.00	840.00	4,600.00
4	研发试验场地	2,575.14	463.53	772.54	4,800.00
合计		13,295.36	2,393.16	2,924.98	4,000.00

本次募投项目实施地点为惠州市，根据公开资料显示，其他上市公司在惠州市新建项目场所造价的具体情况如下：

公司名称	项目名称	场地投资金额(万元)	建筑面积 (m ²)	单位造价 (元/m ²)
诺德股份	惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目	14,202.00	39,358.00	3,608.42
硕贝德	5G 散热组件建设项目(新建制造楼)	4,464.24	11,748.00	3,800.00
杰普特	半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目	2,891.00	7,000.00	4,130.00
	半导体激光器扩产建设项目	2,050.00	5,000.00	4,100.00

由上可以看出，公司本次募投项目单位造价与其他上市公司披露的惠州地区

募投项目自建场所的单位造价不存在较大差异，具有合理性。

2、设备及软件投资

本项目涉及的产品主要为针对 Mini/Micro-LED 显示屏幕的智能组装及检测设备。为提高募投产品的研发水平及自主生产能力，进一步提升公司的产品交期管控和质量控制水平，本项目将引进自动化程度更高、更先进的生产设备及配套软件。在综合考虑项目的产品特点、产品负荷、产品质量检测、生产工艺流程设计以及综合管理等实际情况需要的基础上，合理估算项目所需具体设备及软件投资金额为 6,448.36 万元，其中生产设备投资 4,887.36 万元，研发设备投资 502.50 万元，管理及办公设备投资 450.00 万元，软件投资 608.50 万元。设备及软件的数量系主要基于项目预计需求而确定，设备及软件的价格主要参照相同或类似规格/型号设备及软件的市场价格测算得出。设备及软件投资的具体明细如下：

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
1	切管机	生产设备	P6018D-H3000	台	165.00	1	165.00
2	切割机	生产设备	G4020PRO	台	76.00	1	76.00
3	切割机	生产设备	G6025F	台	148.00	1	148.00
4	折弯机	生产设备	1003	台	33.80	1	33.80
5	折弯机	生产设备	1254	台	38.80	1	38.80
6	折弯机	生产设备	5013	台	25.80	1	25.80
7	龙门加工中心	生产设备	BF-6036L	台	280.00	2	560.00
8	龙门加工中心	生产设备	BF-8032L	台	290.00	1	290.00
9	焊接平台	生产设备	6米×3米	台	4.00	4	16.00
10	焊接平台	生产设备	4米×2米	台	3.60	4	14.40
11	焊接平台	生产设备	8米×4米	台	8.50	1	8.50
12	龙门铣	生产设备	GMC3080GRV	台	228.00	2	456.00
13	龙门铣	生产设备	GMC2040GRV	台	112.00	2	224.00
14	铣边龙门铣	生产设备	CX6020	台	89.80	1	89.80
15	加工中心	生产设备	BF-V6	台	26.00	8	208.00
16	加工中心	生产设备	BF-V8	台	28.00	12	336.00
17	加工中心	生产设备	BF-2013	台	75.00	5	375.00
18	加工中心	生产设备	BF-3025	台	120.00	4	480.00
19	磨床	生产设备	105SA1	台	89.00	1	89.00
20	手摇磨床	生产设备	ACC450ST	台	12.00	1	12.00
21	手摇磨床	生产设备	HF-618S	台	4.10	4	16.40
22	普通车床	生产设备	CA6140B/A/1500	台	6.70	2	13.40

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
23	数控车床	生产设备	CAK50135	台	13.00	4	52.00
24	摇臂钻床	生产设备	Z3050×16/1	台	7.98	2	15.96
25	镗床	生产设备	BMC-110R ₂	台	270.00	2	540.00
26	五面体加工中心	生产设备	ML-540Z2	台	408.00	1	408.00
27	钻攻机	生产设备	ZQS4116/l	台	0.40	5	2.00
28	线切割	生产设备	CDK63	台	6.10	10	61.00
29	普铣	生产设备	X63254#炮塔铣	台	3.10	15	46.50
30	车铣复合加工中心	生产设备	GLS-3300/LM	台	86.00	1	86.00
31	同步双频感应核心关键元部件 ELDEC	研发设备	/	台	80.00	1	80.00
32	红外测温系统	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
33	专用淬火矫直机床系统	研发设备	/	台	80.00	1	80.00
34	专用淬火冷却系统	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
35	淬火液净化环保系统	研发设备	/	台	50.00	1	50.00
36	16m 恒温平台检测室	研发设备	/	台	25.00	1	25.00
37	高速相机	研发设备	/	台	2.50	5	12.50
38	CameraLink 数据采集卡	研发设备	/	个	0.22	5	1.10
39	远心镜头	研发设备	/	个	0.11	4	0.44
40	同轴光源	研发设备	/	个	0.62	4	2.48
41	光源控制器	研发设备	/	个	0.25	1	0.25
42	激光位移传感器	研发设备	/	个	9.68	4	38.72
43	激光跟踪仪	研发设备	/	台	99.70	1	99.70
44	工控机	研发设备	/	台	0.71	1	0.71
45	激光干涉系统	研发设备	/	台	32.00	1	32.00
46	激光尺系统	研发设备	/	台	28.00	1	28.00
47	伺服电机及其组件	研发设备	/	台	1.50	4	6.00
48	伺服装置	研发设备	/	套	1.40	4	5.60
49	服务器+存储	管理及办公设备	/	套	80.00	1	80.00
50	网络+无线	管理及办公设备	/	套	70.00	1	70.00
51	办公电脑	管理及办公设备	/	台	0.80	100	80.00
52	广播系统	管理及办公设备	/	台	30.00	1	30.00
53	打印复印一体机	管理及办公设备	/	台	2.00	15	30.00
54	投影仪	管理及办公设备	/	台	1.00	5	5.00
55	会议系统	管理及办公设备	/	套	1.50	10	15.00
56	监控系统	管理及办公设备	/	套	50.00	1	50.00
57	门禁系统	管理及办公设备	/	套	20.00	1	20.00
58	考勤系统	管理及办公设备	/	套	25.00	2	50.00
59	防疫系统	管理及办公设备	/	套	20.00	1	20.00

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
60	ERP 管理系统	软件	/	套	150.00	1	150.00
61	PLM 产品数据管理系统	软件	/	套	80.00	1	80.00
62	PMS 项目管理系统	软件	/	套	25.00	1	25.00
63	SRM 供应商管理系统	软件	/	套	10.00	1	10.00
64	业务流程管理系统	软件	/	套	50.00	1	50.00
65	文件加密系统	软件	/	套	30.00	1	30.00
66	资料防泄密系统	软件	/	套	20.00	1	20.00
67	企业防病毒系统	软件	/	套	25.00	1	25.00
68	资料库 ORACLE	软件	/	套	46.00	2	92.00
69	微软系统软件 Winpro	软件	/	套	0.50	100	50.00
70	微软系统软件 OfficeStd	软件	/	套	0.32	100	32.00
71	微软系统软件 WinSvrSTD	软件	/	套	0.80	10	8.00
72	微软系统软件 SQLSvrSTD	软件	/	套	6.00	5	30.00
73	流程图软件	软件	/	套	0.10	50	5.00
74	PDF 编辑软件	软件	/	套	0.05	30	1.50
合计							6,448.36

3、预备费

根据项目生产经营情况，在对整个项目所需流动资金进行合理预算的前提下，本项目拟计划投入预备费，用于项目实施期间由于价格、设计变更等原因引起工程造价变化的开支；本项目的预备费为 738.33 万元，不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。

4、铺底流动资金

本项目铺底流动资金为 3,000 万元，主要综合考虑未来项目应收账款、存货、货币资金等经营性流动资产以及应付账款等经营性流动负债的情况对流动资金的需求等因素的影响而设置，系项目运营早期为保证项目正常运转所必须的流动资金，不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。

由上可知，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目投资总额为 15,504.83 万元，包含场地投资 5,318.14 万元、设备及软件投资 6,448.36 万元、预备费 738.33 万元和铺底流动资金 3,000.00 万元，上述各项投资是在充分考虑项目实际规划所需、项目建设及运营情况、项目不确定支出和保障项目顺利实施等因素的基础上测算得出；其中场地投资、设备及软件投资拟使用本次募集资金，共

计 11,766.50 万元；预备费、铺底流动资金不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。因而，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目投资金额的具体构成清晰明确，测算依据及测算过程具有合理性。

(二) 半导体先进封装测试设备研发及生产项目

本项目拟投资 12,521.87 万元，其中拟使用募集资金投资 8,925.59 万元，具体资金投入情况如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)	是否为资本性支出
1	场地投资	3,545.43	3,545.43	是
2	设备及软件投资	5,380.16	5,380.16	是
3	预备费	596.28	-	否
4	铺底流动资金	3,000.00	-	否
合计		12,521.87	8,925.59	/

半导体先进封装测试设备研发及生产项目的投资金额具体构成、测算依据及测算过程如下：

1、场地投资

本项目场地投资主要为募投产品生产车间的建设及装修，场地总建筑面积为 8,863.57 平方米，场地投资总额为 3,545.43 万元，其中建设投资金额为 1,595.44 万元，装修费投资为 1,949.99 万元。场地总建筑面积主要是在现有可使用土地的基础上根据募投项目生产实际需要确定的；生产车间主要为钢结构和砖混结构，参考现有厂房的标准建设和装修，价格主要根据募投项目实施地当前物价水平确定具体投资情况如下：

序号	项目	建筑面积 (m ²)	建设投资 (万元)	装修费 (万元)	单位造价 (元/ m ²)
1	机加车间	3,000.00	540.00	510.00	3,500.00
2	装配车间	2,116.04	380.89	359.73	3,500.00
3	无尘调试车间	2,200.00	396.00	616.00	4,600.00
4	研发试验场地	1,547.53	278.56	464.26	4,800.00
合计		8,863.57	1,595.44	1,949.99	4,000.00

本次募投项目实施地点为惠州市，根据公开资料显示，其他上市公司在惠州市新建项目场所造价的具体情况参见本回复“1.关于融资规模”之“一、上述各项目投资金额的具体构成，测算依据及测算过程，是否合理”之“（一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”之“1、场地投资”的统计表格。

由上可以看出，公司本次募投项目单位造价与其他上市公司披露的惠州地区募投项目自建场所的单位造价不存在较大差异，具有合理性。

2、设备及软件投资

本项目涉及的产品主要为半导体先进封装及测试设备。为提高募投产品的自主研发能力，进一步提升公司的产品交期管控和生产质量控制水平，本项目将引进自动化程度更高、更先进的生产设备、研发设备及配套软件。在综合考虑项目的产品特点、产品负荷、产品质量检测、生产工艺流程设计以及综合管理等实际情况需要的基础上，合理估算项目所需具体设备及软件投资金额为5,380.16万元，其中生产设备投资4,502.46万元，研发设备投资515.20万元，软件投资362.50万元。设备及软件的数量系主要基于项目预计需求而确定，设备及软件的价格主要参照相同或类似规格/型号设备及软件的市场价格测算得出。设备及软件投资的具体明细如下：

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价 (万元)	数量	金额 (万元)
1	切管机	生产设备	P6018D-H3000	台	165.00	1	165.00
2	切割机	生产设备	G4020PRO	台	76.00	1	76.00
3	切割机	生产设备	G6025F	台	148.00	1	148.00
4	折弯机	生产设备	1003	台	33.80	1	33.80
5	折弯机	生产设备	1254	台	38.80	1	38.80
6	折弯机	生产设备	5013	台	25.80	1	25.80
7	龙门加工中心	生产设备	BF-6036L	台	280.00	2	560.00
8	龙门加工中心	生产设备	BF-8032L	台	290.00	1	290.00
9	焊接平台	生产设备	6米×3米	台	4.00	4	16.00
10	焊接平台	生产设备	4米×2米	台	3.60	4	14.40
11	焊接平台	生产设备	8米×4米	台	8.50	1	8.50
12	龙门铣	生产设备	GMC3080GRV	台	228.00	2	456.00
13	龙门铣	生产设备	GMC2040GRV	台	112.00	2	224.00
14	铣边龙门铣	生产设备	CX6020	台	89.80	1	89.80
15	加工中心	生产设备	BF-V6	台	26.00	8	208.00
16	加工中心	生产设备	BF-V8	台	28.00	12	336.00
17	加工中心	生产设备	BF-2013	台	75.00	4	300.00
18	加工中心	生产设备	BF-3025	台	120.00	4	480.00
19	磨床	生产设备	105SA1	台	89.00	1	89.00
20	手摇磨床	生产设备	ACC450ST	台	12.00	1	12.00
21	手摇磨床	生产设备	HF-618S	台	4.10	4	16.40

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价 (万元)	数量	金额 (万元)
22	普通车床	生产设备	CA6140B/A/1500	台	6.70	2	13.40
23	数控车床	生产设备	CAK50135	台	13.00	4	52.00
24	摇臂钻床	生产设备	Z3050×16/1	台	7.98	2	15.96
25	镗床	生产设备	BMC-110R ₂	台	270.00	1	270.00
26	五面体加工中心	生产设备	ML-540Z2	台	408.00	1	408.00
27	钻攻机	生产设备	ZQS4116/I	台	0.40	5	2.00
28	线切割	生产设备	CDK63	台	6.10	6	36.60
29	普铣	生产设备	X63254	台	3.10	10	31.00
30	车铣复合加工中心	生产设备	GLS-3300/LM	台	86.00	1	86.00
31	移动平台影像仪	研发设备	/	台	30.00	1	30.00
32	2.5D 投影仪	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
33	三坐标测量仪	研发设备	/	台	50.00	1	50.00
34	轮廓测量仪	研发设备	/	台	15.00	1	15.00
35	表面粗糙度测量仪	研发设备	/	台	10.00	1	10.00
36	硬度测试机	研发设备	/	台	10.00	1	10.00
37	高度测量仪	研发设备	/	台	5.00	2	10.00
38	非接触式白光高度测试平台	研发设备	/	台	12.00	1	12.00
39	高倍率金像显微镜	研发设备	/	台	50.00	1	50.00
40	激光干涉仪	研发设备	/	台	30.00	1	30.00
41	光谱分析仪	研发设备	/	台	15.00	1	15.00
42	拉力测试仪	研发设备	/	台	10.00	1	10.00
43	线轨老化测试平台	研发设备	/	台	12.00	3	36.00
44	线轨噪音测试平台（含分贝仪）	研发设备	/	台	7.00	2	14.00
45	工作台	研发设备	/	台	0.50	10	5.00
46	恒温恒湿箱	研发设备	/	台	1.70	1	1.70
47	置物箱（带防潮）	研发设备	/	台	0.30	5	1.50
48	视觉打光测试平台（含各种光源）	研发设备	/	台	15.00	1	15.00
49	视觉镜头测试平台（含各种镜头）	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
50	低速示波器	研发设备	/	台	20.00	1	20.00
51	高速示波器	研发设备	/	台	100.00	1	100.00
52	灵敏电流计	研发设备	/	个	20.00	1	20.00
53	万用表	研发设备	/	个	5.00	2	10.00
54	信号发生器	研发设备	/	个	10.00	1	10.00
55	结构设计软件 3D	研发软件	/	套	7.50	20	150.00
56	辅助设计软件 2D	研发软件	/	套	0.50	30	15.00
57	力学仿真软件	研发软件	/	套	25.00	1	25.00
58	专业渲染软件	研发软件	/	套	30.00	1	30.00

序号	名称	类别	规格型号	单位	单价 (万元)	数量	金额 (万元)
59	设计插件软件	研发软件	/	套	0.05	50	2.50
60	计算机辅助制造	研发软件	/	套	15.00	5	75.00
61	算法开发、数据分析软件	研发软件	/	套	5.00	5	25.00
62	测试开发软件	研发软件	/	套	4.00	5	20.00
63	程序开发软件	研发软件	/	套	2.00	10	20.00
合计							5,380.16

3、预备费

根据项目生产经营情况，在对整个项目所需流动资金进行合理预算的前提下，本项目拟计划投入预备费，用于项目实施期间由于价格、设计变更等原因引起工程造价变化的开支；本项目的预备费为 596.28 万元，不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。

4、铺底流动资金

本项目铺底流动资金为 3,000 万元，主要综合考虑未来项目应收账款、存货、货币资金等经营性流动资产以及应付账款等经营性流动负债的情况对流动资金的需求等因素的影响而设置，系项目运营早期为保证项目正常运转所必须的流动资金，不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。

由上可知，半导体先进封装测试设备研发及生产项目投资总额为 12,521.87 万元，包含场地投资 3,545.43 万元、设备及软件投资 5,380.16 万元、预备费 596.28 万元和铺底流动资金 3,000.00 万元，上述各项投资是在充分考虑项目实际规划所需、项目建设及运营情况、项目不确定支出和保障项目顺利实施等因素的基础上测算得出；其中场地投资、设备及软件投资拟使用本次募集资金，共计 8,925.59 万元；预备费、铺底流动资金不使用本次募集资金，将全部以自有资金投入。因而，半导体先进封装测试设备研发及生产项目投资金额的具体构成清晰明确，测算依据及测算过程具有合理性。

(三) 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目

“平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”系首次公开发行股票并上市时尚未募足所需投资总额的募集资金投资项目，根据整体建设进度计划，该项目本次发行拟使用募集资金金额系截至本次发行董事会召开日尚未投资建设的一部分，具体资金投入情况如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)	是否为资本性支出
1	场地投资	22,611.97	5,307.91	是
1.1	场地建设费	14,895.32	-	是
1.2	场地装修费	7,716.65	5,307.91	是
2	设备及软件投资	2,195.97	-	是
3	铺底流动资金	1,000.00	-	否
合计		25,807.94	5,307.91	/

平板显示器件自动化专业设备生产建设项目的各项规划投资（详情参见《深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第九节 募集资金运用与未来发展规划”）中拟使用本次募集资金的场地投资中的场地装修费，金额为 5,307.91 万元；上述场地装修费是在募投规划建筑面积的基础上，参考募投项目实施地当时的市场价格确定，其中装修费明细如下：

序号	项目	建筑面积 (m ²)	装修费 (万元)	拟使用本次募集资金金额 (万元)	单位装修价格 (元/m ²)
1	厂房	56,039.05	5,603.91	5,307.91	1,000.00
2	宿舍楼	8,442.60	1,013.11	-	1,200.00
3	办公楼	5,674.11	680.89	-	1,200.00
4	其他附属及配套设施	5,344.80	418.74	-	783.45
合计		75,500.56	7,716.65	5,307.91	1,022.07

本次募投项目实施地点为惠州市，根据公开资料显示，其他上市公司在惠州市新建项目场所装修的具体情况如下：

公司名称	项目名称	装修费 (万元)	建筑面积 (m ²)	单位装修价格 (元/m ²)
科达利	惠州动力锂电池精密结构件新建项目（厂房及宿舍）	11,751.20	153,680.00	764.65
奥拓电子	Mini LED 智能制造基地建设 项目	1,125.00	7,500.00	1,500.00

由上可知，其他上市公司披露的惠州地区募投项目场所的装修单位造价根据各个公司的实际情况设定，存在一定的跨度空间，考虑到装修本身具有一定的弹性，公司平板显示器件自动化专业设备生产建设项目装修单位造价根据自身需求和当时装修市场情况设计规划，在上述可比项目的跨度范围内，具有合理性。

综上所述，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目和平板显示器件自动化专业设备生产建设项目投资金额的具体构成清晰明确，测算依据及测算过程具有合理性。

二、根据投资构成中非资本性支出的情况及《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第 4 问，补充流动资金比例是否超过募集资金总额的 30%

发行人本次募集资金用于惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目和平板显示器件自动化专用设备生产建设项目的部分拟全部用于场地建设、场地装修、设备及软件购置等，均为资本性支出，不存在非资本性支出的情况；发行人本次募集资金用于补充流动资金的金额为 10,000.00 万元，占本次拟募集资金总额比例为 27.78%，未超过本次募集资金总额的 30%。

三、申报会计师的核查程序和核查意见

（一）核查程序

申报会计师履行了以下主要核查程序：

- 1、获取投资项目的具体构成、测算依据资料和测算过程表，核查是否合理；
- 2、核查投资构成中的非资本性支出情况，与《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第 4 问进行比对，核查补充流动资金比例是否超过募集资金总额的 30%。

（二）核查结论

- 1、惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目和平板显示器件自动化专用设备生产建设项目投资金额的具体构成、测算依据及测算过程具有合理性；
- 2、本次募集资金用于补充流动资金的金额为 10,000.00 万元，占本次拟募集资金总额比例为 27.78%，未超过本次募集资金总额的 30%。

2.关于收益测算

根据首轮回复，1) 深科达智能制造创新示范基地续建工程两个子项目的相关产品预计销量是根据公司研发水平、产品竞争优势、下游市场需求，配合公司的市场和客户调研做出的。2) 相关成本费用参照近几年企业的历史数据及项目实际进行测算。

请发行人说明：（1）销量预计依据的详细情况，结合公司市场地位、可比公司同类产品销量或规划销量，销量预计是否审慎、合理；（2）结合该项目与公司近几年历史项目的差异，成本费用的测算方法是否合理，列表对比募投项目与公

司历史的成本费用占比，相关成本费用测算是否完整。

请申报会计师核查并发表意见。

回复：

一、销量预计依据的详细情况，结合公司市场地位、可比公司同类产品销量或规划销量，销量预计是否审慎、合理

（一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目

1、销量预计依据的详细情况

鉴于本项目针对的 Mini/Micro-LED 显示模组组装和检测设备暂无权威统一的市场需求预测数据，公司综合考虑未来新型显示行业的市场发展情况、潜在客户的需求状况、公司产品或服务的竞争优势、公司的销售策略等因素，结合公司自身业务发展规划情况确定本次募投项目产品的销售数量，具体如下：

深科达在智能装备领域深耕多年，积累了深厚的技术储备和丰富的项目管理经验，具备了较强的自动化整合优势，致力于为客户提供全自动一体化综合解决方案，故而本次募投项目规划产品设定为全自动组装和检测自动化生产线。

此外，公司已经于 2021 年参与苹果公司 Mini-LED 背光显示屏幕产品生产线的构建，初步构建规模为两条，根据与客户的沟通情况，预计未来会有另外 4 条线的设备需求；同时，公司与一家非苹果公司也进行了初步沟通获取了需求信息，预计需求为 2 条生产线，因而合理预计未来 2-3 年会有 6 条线的设备采购需求，基于谨慎性原则，本项目预计销量在实施后第三年（达产第一年）的产能释放率设定为 11 条线的 50%，考虑到随着 Mini/Micro-LED 显示技术的不断成熟和市场空间的逐渐扩大，公司销售也将随之拓展的情况，故而采用渐进式释放产能的方式，设定 100%达产规划为 11 条自动线。此外，根据立鼎产业研究中心数据，2018 年全球 Mini/Micro-LED 市场规模为 2,810 万美元，其中 Mini-LED 占比为 35.6%，达 1,000 万美元。到 2024 年，全球 Mini-LED 市场规模将达 23.2 亿美元，2018-2024 年复合增长率将达到 147.9%，下游市场的预计增长速度远超本次募投规划产能释放速度，说明本次销量规划具备一定的审慎性。

2、结合公司市场地位、可比公司同类产品销量或规划销量，销量预计是否审慎、合理

（1）公司市场地位

公司一直致力于自主研发和知识产权的保护及转化应用，是国家级高新技术企业，先后获得了“工信部认定第一批专精特新‘小巨人’企业”“广东省高能效显示面板智能装备工程技术研究中心”“广东省第五批机器人骨干（培育）企业”“广东省信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业”“广东省战略性新兴产业培育企业（智能制造领域）”“广东省著名商标”“入选‘广东省智能制造试点示范项目’”“入选‘深圳市 2019 年度战略性新兴产业专项资金新兴产业扶持计划第四批资助项目’”“入选‘深圳市 2018 年第一批战略性新兴产业和未来产业专项资金扶持计划项目’”“入选‘深圳市 2017 年首台（套）重大技术装备应用扶持计划项目’”“第四届全球触控、蓝宝石行业最具影响力企业评选优秀供应商”“第十四届深圳企业创新纪录奖”等殊荣。

通过多年的持续努力，公司突破并掌握了精准对位、图像处理、运动控制、精密压合贴附等方面的核心技术，已具备提供涵盖 OLED 和 LCD 显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力，并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力，可为客户提供一站式解决方案，是国内具备平板显示模组全自动组装和检测设备研发和制造能力的企业之一。依靠先进的技术、稳定的产品性能、完善的售后技术支持，公司产品获得了天马微电子、华星光电、业成科技、华为、京东方、维信诺、友达光电、伯恩光学、蓝思科技、欧菲光等境内外知名企业的一致认可，在平板显示器件生产设备行业有较高的美誉度和品牌影响力。

此外，公司与主要竞争对手经营情况的对比（2021 年 6 月末/1-6 月）情况如下表：

单位：万元

公司名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润	综合毛利率
联得装备	227,946.43	142,559.44	44,806.26	1,088.90	25.41%
易天股份	136,700.96	80,815.19	20,822.06	4,820.87	48.97%
鑫三力	116,094.93	41,722.39	16,809.07	-5,815.44	32.18%
集银科技	50,486.02	18,925.22	14,465.92	-949.86	27.75%
平均值	132,807.08	71,005.56	24,225.83	-213.88	33.71%
深科达	140,730.56	77,319.80	41,351.67	3,611.20	34.37%

注：1) 鑫三力为上市公司智云股份的子公司，其财务数据来源于智云股份 2021 年半年度报告，其中资产总额、资产净额、营业收入、净利润是鑫三力的财务指标，综合毛利率为智云股份平板显示模组设备对应数据；

2)集银科技是上市公司正业科技的子公司,其财务数据来源于正业科技2021年半年度报告,其中资产总额、资产净额、营业收入、净利润是集银科技的财务指标,综合毛利率为正业科技平板显示模组自动化对应数据。

2018年-2021年上半年,公司与主要竞争对手的研发投入占营业收入对比情况如下表:

公司名称	研发投入占比			
	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
联得装备	9.93%	8.50%	9.72%	8.59%
易天股份	9.82%	9.42%	7.17%	6.67%
正业科技	7.50%	9.36%	11.60%	8.24%
智云股份	16.25%	5.25%	19.58%	4.19%
平均	10.87%	8.13%	12.02%	6.92%
深科达	8.42%	9.38%	10.09%	9.46%

注:由于集银科技和鑫三力研发投入信息未公开,故与其上市母公司公开数据进行对比。

2018年-2021年上半年,公司与主要竞争对手的研发人员占员工总数比例对比情况如下表:

公司名称	研发人员占比			
	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
联得装备	35.43%	28.33%	29.31%	27.80%
易天股份	/	29.73%	31.36%	27.02%
正业科技	/	32.29%	32.24%	27.15%
智云股份	/	22.18%	18.44%	17.45%
平均	/	28.13%	27.84%	24.86%
深科达	26.50%	29.53%	36.52%	36.67%

注:由于集银科技和鑫三力研发人员和员工数量信息未公开,故与其上市母公司公开数据进行对比。

截至2021年6月30日,公司与同行业可比公司拥有的授权专利和软件著作权对比情况如下表:

公司名称	获得授权专利和软件著作权情况
联得装备	截至2019年6月末,已获授权专利83项,计算机软件著作权授权49项
易天股份	截至2021年6月末,已获得授权专利112项,软件著作权88项
正业科技	截至2021年6月末,已获授权发明专利130余件,软件著作权共180余件
智云股份	截至2021年6月末,已获授权专利140项,计算机软件著作权授权65项
深科达	截至2021年6月末,已获授权专利277项,计算机软件著作权授权38项

注：由于集银科技和鑫三力专利和软件著作权信息未公开，故与其母公司公开数据进行对比；联得装备未公布截至2019年6月末之后的专利和软件著作权信息，故选取其已公开的截至2019年6月30日的数据进行对比。

由上可知，与同行业可比公司相比，深科达在业务经营方面、研发投入、研发人员规模、专利和计算机软件著作权保有量等方面具有一定的优势和市场地位。

公司多年来在平板显示领域的积累，为本次募投项目预计销量的顺利实现奠定了坚实的技术、客户和市场基础。

(2) 可比公司同类产品销量或规划销量

根据公开披露信息，除发行人外，参与 Mini/Micro-LED 相关设备研制和生产的 企业还有联得装备（300545.SZ）、智云股份（300097.SZ）、华兴源创（688001.SH）和精测电子（300567.SZ），相关信息如下：

公司名称	相关产品	相关产品销量/达产规划
联得装备	Mini-LED ACF 贴附 & COFPunch 设备、Mini-LED 全自动 PCB 绑定设备	未披露
智云股份	已公布设立研发中心进行研究	未披露
华兴源创	Mini/Micro-LED 和 Micro-OLED 平板显示检测设备	新项目规划销量： Mini/Micro-LED 和 Micro-OLED 平板显示自动化检测设备，新增产能 40 台/年； Micro-OLED Mura 检测及修复设备，新增产能 18 台/年； 规划销售收入：20,010.00 万元/年
精测电子	Micro-LED 显示全制程检测设备	新项目规划销量： Micro-LED 光学仪器测量设备，新增产能 650 台/年； Micro-LED 检测与修复设备，新增产能 140 台/年； 基于 AI 的 Micro-LED 面板柔性检测设备，新增产能 80 台/年； Micro-LED 芯片 ATE 设备，新增产能 30 台/年； 规划销售收入：69,300.00 万元/年

信息来源：上市公司公开披露文件。

由上表可知，Mini/Micro-LED 产品生产技术尚未成熟，Mini/Micro-LED 屏幕应用产品的大规模商业化并未完全落地，国内针对 Mini/Micro-LED 显示模组的组装和检测设备生产厂家主要系深耕显示装备领域的少数企业，数量相对有限，上述参与者规划的产品基本都是单机类型的设备，公司本次规划产品均为自动线，具有一定的优势。

综上，公司综合考虑了未来新型显示行业的市场发展情况、潜在客户的需求状况、公司产品或服务的竞争优势、公司的销售策略、同行业在该领域的布局进

程等因素，结合公司自身业务发展规划情况以确定本次募投项目产品的销售数量；公司利用自身在平板显示设备领域积累的技术优势和市场地位，紧抓 Mini/Micro-LED 新型显示产业的发展机遇期，为本次募投项目规划产品预计销量的顺利实现奠定了良好的基础，因而本次募投项目的销量预计具有审慎性和合理性。

（二）半导体先进封装测试设备研发及生产项目

1、销量预计的详细情况

公司综合考虑半导体封测设备行业的市场发展情况、潜在客户的需求状况、公司产品研发计划、公司的销售策略等因素，结合公司自身业务发展规划情况确定本次募投项目产品的销售数量，具体如下：

（1）市场规模预测

根据 SEMI 国际半导体产业协会数据，2020 年全球半导体设备市场规模 712 亿美元，同比增长 19.06%，创历史新高，2015-2020 年复合增速 14.30%。芯片产能紧张局势仍将延续，预计未来两年半导体设备将继续保持高景气度。区域分布上，2020 年中国大陆和中国台湾半导体设备规模分别为 187.2 亿美元和 171.5 亿美元，分别占全球市场的 26.26%和 24.16%，中国大陆成为全球半导体设备第一大市场。同时 SEMI 预测，2021 年全球半导体设备销售额将首次突破 1000 亿美元大关，达到 1030 亿美元。另外根据 SEMI 数据，封装测试环节设备市场约占半导体设备市场 10%，根据 Yole 的预测，先进封装市场规模由 2019 年的 288 亿美元增长至 2025 年的 422 亿美元，占比由 2019 年的 42.6%有望提升至 2025 年的 49.4%。由此推算，即使以 2021 年全球半导体设备销售规模测算，2025 年中国大陆先进封装测试设备市场规模也将达到约 13.4 亿美元（ $1030 \times 26.26\% \times 10\% \times 49.4\% \approx 13.4$ ，折合人民币约 85 亿元），基于谨慎性原则，本次测算假定后续市场规模保持 85 亿元不变。

（2）市场占有率预测

根据 CSA Research、中国半导体行业协会及 SEMI 数据，预计 2022 年全球半导体测试设备将达到 56.12 亿美元，预计 2022 年我国半导体测试设备规模将达到 103.22 亿元。根据 SEMI 数据，2018 年我国测试机、分选机、探针台投资规模分别占测试设备总规模的 63.10%、17.40%、15.20%。以此半导体产线投资配置比例测算，则 2022 年我国半导体测试分选机市场规模约为 83.08 亿元。公司半导体测试分选设备 2021 年预计收入为 2.50-3.00 亿元，基于谨慎性原则在假定不增长的

情况下，2022 年公司半导体测试分选设备的市场占有率约为 2.41%-3.41%，相应的公司规划本次募投项目在项目实施后第五年达到稳产后的市场占有率也为该区间。

基于以上测算数据，规划本次募投项目的规划稳产后的销售收入区间为 2.05-3.07 亿元（85 亿元*【2.41%-3.41%】 \approx 【2.05-3.07】亿元），区间中值为 2.56 元。

同时，考虑到：1）发行人本次募投项目针对的客户群体为国内大型封测厂商，在该领域发行人已经积累了一定的客户资源，与扬杰科技、华天科技、通富微电、山东晶导微电子股份有限公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司等企业建立了合作关系，充分掌握了客户的实际需求；2）深科达拟利用自身在智能装备领域的自动化整合优势，旨在帮助客户构建一体化全自动封装测试线以达到提升生产效率、降低生产成本的目的；3）根据封装测试产线的设备配比情况，考虑到自身研发水平和研发项目的进展状况，对募投产品的数量进行调整，再依照 2-3 亿元的收入规模和预估设备销售单价分配各类设备的预计销售数量，进而最终确定本次募投项目产品的销售数量。

2、结合公司市场地位、可比公司同类产品销量或规划销量，销量预计是否审慎、合理

（1）公司市场地位

基于对半导体行业发展的判断，深科达整合自身技术优势，通过子公司深科达半导体于 2016 年切入半导体封测设备领域，并陆续向市场推出测试分光机、测试分选机等半导体封测系列产品。报告期内，半导体封测设备的销售收入分别为 2,164.71 万元、3,992.99 万元、12,051.82 万元和 20,316.47 万元，年复合增长率高达 135.95%，相关产品获得了市场的广泛认可，与扬杰科技、华天科技、通富微电、山东晶导微电子股份有限公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司等企业建立了合作关系，累计积累了众多优质客户群体，市场占有率逐年提升。

半导体后道测试设备主要包括测试机、分选机、探针台三大类，深科达半导体目前的主要产品为分选机，在该细分领域，国内分选机龙头为长川科技，深科达半导体与长川科技 2018 年-2021 年上半年的分选机销售对比情况如下：

公司名称	营业收入（万元）			
	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
长川科技（A）	38,166.30	55,873.35	26,398.23	11,753.63
深科达半导体（B）	10,443.47	12,051.82	3,992.99	2,164.71
A/B	3.65	4.64	6.61	5.43

此外，根据深科达 2021 年年度业绩快报，公司 2021 年度分选机销售收入约为 2.72 亿元（未经审计），近年来深科达半导体分选机的销售收入保持快速增长态势。

公司多年来在半导体封测设备领域的积累，为本次募投项目预计销量的顺利实现奠定了坚实的技术、客户和市场基础。

（2）可比公司同类产品销量或规划销量

根据公开披露信息，除发行人外，参与本次募投规划涉及相关设备研制和生产的公司还有新益昌（688383.SH）、长川科技（300604.SZ）、光力科技（300480.SZ）、华兴源创（688001.SH）和联得装备（300545.SZ），相关信息如下：

公司名称	已有产品/规划项目	相关产品销量/规划销量
新益昌	半导体固晶机	2020 年和 2019 年销售收入分别为 2,170.33 万元和 2,268.21 万元,销量为 89 台和 103 台
长川科技	探针台研发及产业化项目	新项目规划销量： 探针台 485 台，其中 CP12-SOC/CIS（200 台）、CP12-Memory（120 台）、CP12-Discrete（75 台）、CP12-SiC/GaN（90 台）； 规划销售收入：40,740.00 万元/年
光力科技	半导体智能制造产业基地项目（一期）	新项目规划销量： 划片机 300 台； 规划销售收入：64,200.00 万元/年
华兴源创	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	新项目规划销量：每年新增 SIP 分选机 70 台（套），SIP 测试机 70 台（套），治具及配件 8,960 个； 规划销售收入：49,532.00 万元/年
联得装备	半导体封测智能装备建设项目	新项目规划销量：COF 倒装设备 50 套，IGBT 芯片及模组封装设备 50 套； 规划销售收入：23,000.00 万元/年

注：上述信息来源于上市公司公开披露信息；另外表中探针台也可称为 CP 测试机。

根据 SEMI 预测，2021 年全球半导体设备销售额将首次突破 1000 亿美元大关，达到 1030 亿美元。另外根据 SEMI 数据，封装测试环节设备市场约占半导体设备市场 10%，参照 2020 年中国大陆和中国台湾半导体设备规模分别占全球市场的 26.26%和 24.16%比例测算，预计 2021 年中国大陆半导体封装测试设备市场规模约为 27 亿美元（ $1030 \times 10\% \times 26.26\% \approx 27$ 亿美元，折合人民币约为 172 亿），假定该市场规模不变的情况下，按照目前各个同行业可比公司募投项目的销售规

划测算的未来市场占有率情况如下：

公司	长川科技	光力科技	华兴源创	联得装备	深科达
规划销售额（万元）	40,740.00	64,200.00	49,532.00	23,000.00	25,915.00
市场占有率	2.37%	3.73%	2.88%	1.34%	1.51%

注：本次市场占有率仅以各个公司募投规划销售额测算。

由上可知，目前国内参与本次募投项目规划所涉产品的企业并不多，除部分产品已有少量销售外，大多处于市场开拓阶段；各个企业规划的销售额相比不断扩大的国内市场需求而言，存有一定的国产替代空间，伴随着国内半导体产业的崛起和相关设备国产化趋势的不断显现，公司未来在半导体先进封装测试设备领域的发展大有可为。

综上，公司综合考虑了半导体封测设备行业的市场发展情况、潜在客户的需求状况、公司产品研发计划、同行业企业当前研制进展与布局等因素，结合公司自身业务发展规划情况以确定本次募投项目产品的销售数量；公司利用自身在半导体封测设备领域积累的技术优势和市场地位，紧抓国内半导体产业迅速发展和封测设备国产化的战略机遇期，为本次募投项目规划产品预计销量的顺利实现奠定了良好的基础，因而本次募投项目的销量预计具有审慎性和合理性。

二、结合该项目与公司近几年历史项目的差异，成本费用的测算方法是否合理，列表对比募投项目与公司历史的成本费用占比，相关成本费用测算是否完整

（一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目

惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目测算的成本费用与公司历史数据对比情况如下表：

序号	项目	本次募投项目		2020 年度		2019 年度	
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
1	生产成本	24,276.54	62.73%	26,270.16	60.25%	22,489.93	63.40%
1.1	直接材料费用	20,509.94	53.00%	23,463.06	53.81%	20,607.71	58.09%
1.2	人工费用	2,350.00	6.07%	796.87	1.83%	545.67	1.54%
1.3	折旧及摊销	642.64	1.66%	1,017.29	2.33%	793.86	2.24%
1.4	其他制造费用	773.96	2.00%	992.93	2.28%	542.69	1.53%
2	销售费用	4,256.78	11.00%	6,906.97	10.66%	5,513.51	11.68%
3	管理费用	2,321.88	6.00%	3,512.05	5.42%	3,401.40	7.21%
4	研发费用	3,482.82	9.00%	6,076.95	9.38%	4,762.40	10.09%

序号	项目	本次募投项目		2020 年度		2019 年度	
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
5	财务费用	-	-	416.92	0.64%	125.07	0.27%
6	税金及附加	271.66	0.70%	275.98	0.43%	222.29	0.47%
7	所得税	573.07	1.48%	628.98	0.97%	290.17	0.61%
	收入	38,698.00	/	43,604.00	/	35,475.67	/

注：本表中 2019 年和 2020 年的生产成本和收入计取的是公司当期平板显示模组类设备的数据，销售费用、管理费用、研发费用、税金及附加和所得税计取的是公司当期的合并报表数据。

由上表可知，1) 本次募投项目总的生产成本与公司历史数据相当，处于合理水平；其中直接材料费用、其他制造费用与历史数据相当；由于本项目是在自建厂房里通过购买相关设备进行自主机加工的方式生产，与原来主要在租赁厂房和机加工主要通过外协方式进行生产的情况有所不同，故而折旧及摊销与公司历史数据存在一定的差异；由于本次募投公司将加强自主生产能力的投入，增加装配和机加工人员的招聘和培养，提升订单的交期管控和产品质量控制能力，故而人工费用占比较历史数据有所增加；2) 销售费用、管理费用和研发费用与公司历史数据相当，具有合理性；3) 本项目暂未考虑财务费用；4) 本次募投项目税金及附加和所得税测算暂未考虑软件增值税即征即退的影响，故而会高于公司历史数据，具有合理性。

(二) 半导体先进封装测试设备研发及生产项目

半导体先进封装测试设备研发及生产项目测算的成本费用与公司历史数据对比情况如下表：

序号	项目	本次募投项目		2020 年度		2019 年度	
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
1	生产成本	17,215.43	66.43%	8452.31	69.63%	2869.17	71.95%
1.1	直接材料费用	13,994.10	54.00%	7942.21	65.43%	2611.02	65.48%
1.2	人工费用	2,170.00	8.37%	123.99	1.02%	94.92	2.38%
1.3	折旧及摊销	533.03	2.06%	1.65	0.01%	2.25	0.06%
1.4	其他制造费用	518.30	2.00%	384.46	3.17%	160.98	4.04%
2	销售费用	1,295.75	5.00%	904.83	7.45%	504.72	12.66%
3	管理费用	1,036.60	4.00%	441.44	3.64%	272.31	6.83%
4	研发费用	2,332.35	9.00%	432.53	3.56%	256.52	6.43%

序号	项目	本次募投项目		2020 年度		2019 年度	
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
5	财务费用	-	-	72.43	0.60%	57.15	1.43%
6	税金及附加	177.88	0.69%	41.92	0.35%	8.38	0.21%
7	所得税	578.55	2.23%	191.82	1.58%	-16.69	-0.42%
	收入	25,915.00	/	1,2138.75	/	3,987.82	/

注：本表中 2019 年和 2020 年的各类费用成本计取的是子公司深科达半导体当期的财务数据。

由上表可知，1) 本次募投项目的生产成本较子公司深科达半导体的历史数据低，原因在于本次募投所涉产品相较于目前公司的分选测试设备在技术指标、应用范围、设备稳定性和性能方面有所优化升级，整体毛利率水平高于现有半导体类设备；其中直接材料费用、其他制造费用占比与毛利率水平相当的平板显示模组类设备的历史数据相吻合；由于本项目是在自建厂房里通过购买相关设备进行自主机加工的方式生产，与原来主要在租赁厂房和机加工主要通过外协方式进行生产的情况有所不同，故而折旧及摊销与公司历史数据存在一定差异；由于本次募投公司将加强自主生产能力的投入，增加装配和机加工人员的招聘和培养，提升订单的交期管控和产品质量控制能力，故而人工费用占比较历史数据有所增加；2) 由于本项目属于研发及产业化项目，新产品占比较高，前期研发投入较相对成熟的半导体测试分选设备占比高，存在合理性；就销售费用而言，因为会利用现有的渠道和客户进行开拓，其趋势与历史数据变化保持一致；管理费用与子公司深科达半导体的历史数据相当，具有合理性；3) 本项目暂未考虑财务费用；4) 本次募投项目税金及附加和所得税测算暂未考虑软件增值税即征即退的影响，另外深科达半导体 2019 年所得税存在抵扣前期亏损的情况，故而本次募投项目会高于深科达半导体的历史数据，具有合理性。

综上所述，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目和半导体先进封装测试设备研发及生产项目与公司近几年历史项目数据匹配，成本费用的测算方法合理，上述项目成本费用占比与历史数据具有可比性，相关成本费用测算完整。

三、申报会计师的核查程序和核查意见

(一) 核查程序

申报会计师履行了以下主要核查程序：

1、获取销量预测的过程表，分析其是否与发行人情况相符合，销量预计是否审慎合理；

2、获取该项目与近几年历史项目的数据对比情况，分析其成本费用占比是否合理，相关成本费用测算是否完整。

（二）核查结论

经核查，申报会计师认为：

1、发行人结合自身业务发展规划情况确定本次募投项目产品的销售数量，销量预计审慎、合理；

2、经该项目与近几年历史项目的数据对比情况，其成本费用占比合理，相关成本费用测算完整。

3.关于经营情况

根据首轮回复及公开资料，1) 报告期内应收账款占各期营业收入的比重分别为45.26%、58.11%、60.84%和77.07%，最近一年及一期公司对主要客户的信用政策未发生重大变化。2) 公司报告期各期末存货跌价准备计提比例分别为 9.54%、3.06%、1.97%、1.37%，呈现下降趋势，且2019年以来低于可比上市公司平均值；2021年三季度末，发行人仍有较大金额的库存商品无对应订单，且无订单库存商品基本系交付客户试用的设备。3) 2021年前三季度，公司营业收入较上年度增长9.72%，销售费用较上年度增长22.65%，不匹配的原因包括：公司销售人员人数大幅增长；受疫情影响公司员工难以在当地及时开展工作，公司劳务外包支出大幅增长。4) 由于毛利率较高的产品收入占比下降、原材料采购成本上涨、市场竞争加剧及OEM采购占比上升，2021年1-9月公司主营业务毛利率较2020年下降6.94个百分点。5) 根据业绩快报，公司2021年营业收入同比增长 40.62%，归属于母公司所有者的净利润同比下降21.21%。

请发行人说明：（1）信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长的原因及合理性，结合报告期各期应收账款逾期情况，是否存在重大坏账风险；（2）2021年三季度末无订单商品的试用及销售情况，存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值的原因及合理性，进一步论证计提是否充分；（3）结合公司业务规模扩大情况，分析公司销售人员人数及劳务外包支出

同时大幅增长的合理性；（4）原材料市场价及采购价的变动情况是否一致，毛利率下降趋势是否持续，是否对公司经营构成重大不利影响，本次募投项目建成后对公司毛利率的影响；（5）2021年营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配的原因及合理性，公司生产经营是否出现重大不利变化。

请发行人根据回复完善“重大事项提示”及“风险因素”相关内容，按照重要性进行排序，增强针对性。

请申报会计师核查并发表意见。

回复：

一、信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长的原因及合理性，结合报告期各期应收账款逾期情况，是否存在重大坏账风险

（一）信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长的原因及合理性

公司客户收款政策主要为“预收定金-发货款-验收款-质保金”的形式，另外公司根据客户的订单规模、合作程度、商业信用和结算需求以及双方商业谈判的情况，对主要客户信用政策稍作调整，每期付款的金额、比例及时间也存在差异。

最近一年一期对主要客户的付款方式如下：

主要客户名称	2021年1-9月	2020年度
业成科技（成都）有限公司	1、交机后 90 天内 TT80%，最终验收后 90 天内 TT20%； 2、交机后 90 天内 TT70%，最终验收后 90 天内 TT30%； 3、最终验收月份 25 日后 90 天内支付 100%； 4、最终验收后 90 天内支付 100%	1、最终验收月份 25 日后 60 天内支付 100%； 2、交机后 60 天内 TT80%，最终验收后 60 天内 TT20%； 3、最终验收后 60 天内支付 100%； 4、最终验收后 90 天内支付 100%； 5、最终验收月份 25 日后 120 天内支付 100%； 6、最终验收月份 25 日后 90 天内支付 100%； 7、交机后 90 天内 TT80%，最终验收后 90 天内 TT20%
成都京东方光电科技有限公司	送货并开具发票后支付 90%，最终验收支付 10%	
绿点科技（无锡）有限公司	1、验收后 90 天付全额；2、验收后 100% T/T	/
南京一克思德科技有限公司	到货并提供发票支付 90%，质保期满后支付 10%	到货后 90 天付 60%，现场验收后 90 天付 30%，质保一年后 90 天付 10%

主要客户名称	2021年1-9月	2020年度
高视科技（苏州）有限公司（更名前：惠州高视科技有限公司）	1、到货并开据发票后 30 天内，支付 60%，最终验收合格支付 30%，质保期满后 30 天内，支付 10%； 2、签订合同后 7 天内支付 30%，初步检验合格后 7 天内支付 30%，验收合格并提供发票后 7 天内支付 30%，质保期满后支付 10%； 3、签订合同后 7 天内支付 30%，验收合格并提供发票后 7 天内支付 60%，质保期满后支付 10%； 4、签订合同后支付 30%，调试合格运转正常后 30 天内支付 30%，验收合格后支付 30%，质保期满后支付 10%； 5、签订合同后支付 30%，验收合格后支付 60%，质保期满后支付 10%； 6、签订合同后支付 30%，验收合格后 30 天支付 60%，质保期满后支付 10%； 7、月结 30 天	1、合同签订后一个月内，支付 30%，货到两个月内支付 30%，验收合格收到发票后两个月内支付 30%，10%质保金 12 个月内付清； 2、货到验收合格，开具发票后 30 天内支付 80%，安装调试、最终验收合格后 30 天内支付 15%，质保期满后 30 天内支付 5%； 3、签订合同后支付 30%，验收合格后 30 天内支付 60%，质保期后支付 10%； 4、验收合格后支付 100%； 5、到货验收合格，并开具增值税发票 30 天内，支付 60%，最终验收合格支付 30%，质保期满后支付 10%； 6、合同签订后 7 天内支付 30%，到货后 7 天内支付 30%，验收合格并收到发票后 7 天内支付 30%，10%质保金 12 个月内付清； 7、月结 30 天
山东晶导微电子股份有限公司	1、合同签订后付 30%，剩余 70%设备验收后分期 10 个月付清； 2、合同签订后 3 天内支付 30%，剩余 70%货款，设备到厂验收后次月开始分 10 个月付清	
湖北展拓光电科技有限公司	安装调试完成后 30 天内支付 50%，最终验收完成之日起 30 天内支付 40%，剩余款项在终验收之日起 180 天内支付	/
武汉天马微电子有限公司	1、初验收并提供发票后 30 天内支付 70%，验收合格并提供发票后 30 天内支付 25%，质保期满后 30 天内支付 5%； 2、到货验收支付 70%，技术验收支付 30%； 3、到货验收支付 70%，技术验收支付 25%，质保期满支付 5%	初验收并提供发票后 30 天内支付 70%，验收合格并提供发票后 30 天内支付 25%，质保期满后 30 天内支付 5%
光子（深圳）精密科技有限公司	合同签订后 7 天内支付 50%，验收合格后一个月内支付 50%	1、合同签订后 7 天内，支付 50%，验收合格并提供发票后支付 50%； 2、发货前 7 天内，支付 30%，安装调试完毕 7 天内，支付 30%，验收合格后 7 天内支付 30%，验收合格之日起 1 年内支付 10%
广州国显科技有限公司	1、初验收并提供发票后 30 天内支付 70%，最终验收并提供发票后 30 天内支付 20%，质保期满后 30 天内支付 10%； 2、初验收并提供发票后 30 天内支付 90%，最终验收并提供发票后 30 天内支付 10%	1、初验收并提供发票后 30 天内支付 70%，最终验收并提供发票后 30 天内支付 20%，质保期满后 30 天内支付 10%
江苏群力技术有限公司	1、每条线 90 万元的定金需方支付给供方，剩余货款双方另行补充约定； 2、合同签订后支付 20 万元，到货支付 132 万元，设备验收合格后 30 天内支付 450 万元，尾款于签订合同之日起一年内付清	
江西振力达智能装备科技有限公司	1、合同签字后支付 30%，设备安装调试 6 个月后支付 60%，验收合格后一年内支付 10%； 2、合同签字并提供发票后支付 30%，设备安装调试后支付 60%，验收合格后一年内支付 10%	
蓝思科技（长沙）有限公司	1、验收合格并提供发票后 90 天内支付 100%； 2、合同签订后 15 天内支付 30%，送货后 15 天内支付 30%，验收合格并提供发票后 15 天内支付 30%，质保期满后 15 天内支付 10%	

主要客户名称	2021年1-9月	2020年度
厦门天马微电子有限公司	1、初验收并提供发票后22天内支付70%，验收合格并收到发票后22天内支付25%，质保期满后22天内支付5%；2、初验收并提供发票后30天内支付70%，验收合格并收到发票后30天内支付25%，质保期满后30天内支付5%	

注：由于同个客户的不同合同订单因设备的定制化程度不同，对付款条款的约定可能存在差异，因此上表的部分客户具有多条付款政策。

从上表可以看到，报告期内公司主要客户货款结算政策变动不大，货款结算政策主要依据当期交易设备情况、与客户合作关系、商务谈判等因素的不同而有一定的差异，公司整体上对主要客户信用政策未发生重大变化。

报告期各期末，公司应收账款占营业收入的比例如下：

项目	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应收账款占当期营业收入的比例	77.07%	60.84%	58.11%	45.26%

注：上表2021年9月末的数据未作年化处理。2021年9月末应收账款占当期营业收入的比例较高，也受到其计算分母系2021年1-9月的营业收入的影响，而2018年度至2020年度的比例计算分母系该年度的营业收入。

公司2018年第四季度、2019年第四季度和2020年第四季度的主营业务收入占全年的比例分别为26.81%、45.76%和48.82%，2020年第四季度确认的收入占比较高，加上信用期影响，截至年底较多货款尚在付款信用期内，导致2020年末应收账款余额较高，占当期营业收入的比例较高。

公司2021年9月末应收账款占当期营业收入的比例较大，一方面，公司在2021年第三季度确认的主营业务收入占前三季度主营业务收入的比例为41.83%，另一方面，2021年9月末应收账款占当期营业收入的比例较高，还受到其计算分母系2021年1-9月的营业收入的影响，而2018年度至2020年度的比例计算分母系该年度的营业收入。

此外，2020年度、2021年1-9月半导体设备收入金额分别为12,051.82万元和20,316.47万元，半导体设备收入增长较快。近年来，在贸易战的背景下和国内政策的支持下，半导体封测行业发展迅速，在主要设备供应商中，国外封测设备供应商竞争力较强，国内也有部分厂商在争抢赛道。报告期内，公司半导体业务正处于市场开拓前期，业务规模正在爬坡，半导体设备具有类标准化特点，公司与国内外的同行业公司产品同质化程度较高，可替代性较强，为了快速开拓市场和新客户，抢占市场先机，公司在报告期内对半导体设备的销售采用连贯、稳定

且相对宽松的信用政策，信用期主要为设备验收后的3-9个月内支付除已交定金外的剩余货款，随着半导体设备收入的快速增长，公司期末应收账款余额也随之增长。

报告期各期，公司应收账款占营业收入的比例与同行业可比上市公司的情况如下：

公司名称	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
联得装备	82.95%	49.19%	42.93%	38.14%
易天股份	62.89%	41.92%	33.53%	30.15%
智云股份	107.04%	47.93%	121.45%	69.67%
正业科技	62.83%	57.32%	72.24%	59.88%
可比公司平均值	78.93%	49.09%	67.54%	49.46%
深科达	77.07%	60.84%	58.11%	45.26%

注：上表2021年9月末的数据未作年化处理。2021年9月末应收账款占当期营业收入的比例较高，也受到其计算分母系2021年1-9月的营业收入的影响，而2018年度至2020年度的比例计算分母系该年度的营业收入。

由上表可知，公司应收账款占营业收入的比重在2020年末较可比公司平均值高，2018年末、2019年末及2021年9月末均较可比公司平均值低，整体上与可比公司平均值差异较小。2021年9月末，同行业可比公司的应收账款占营业收入的比重均大幅增长，也受到其计算分母系2021年1-9月的营业收入的影响，而2018年度至2020年度的比例计算分母系该年度的营业收入。

综上，公司信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长，符合公司生产经营实际，具有合理性，2021年9月末应收账款占营业收入比重较上年末大幅增长的趋势与同行业可比公司相匹配。

（二）结合报告期各期应收账款逾期情况，是否存在重大坏账风险

报告期各期末，公司应收账款逾期情况如下：

单位：万元

类别	2021-9-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内	43,000.19	70.69%	32,839.73	69.59%	21,795.23	73.44%	14,728.74	65.93%
信用期外	17,833.25	29.31%	14,353.89	30.41%	7,884.08	26.56%	7,610.24	34.07%
合计	60,833.44	100.00%	47,193.62	100.00%	29,679.31	100.00%	22,338.98	100.00%

报告期各期末公司应收账款余额中信用期外占比分别为34.07%、26.56%、

30.41%和 29.31%，波动幅度较小。

报告期各期末，公司逾期应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

时间	逾期应收账款余额	期后回款金额	期后回款比例
2021-9-30	17,833.25	10,680.73	59.89%
2020-12-31	14,353.89	11,673.42	81.33%
2019-12-31	7,884.08	7,597.43	96.36%
2018-12-31	7,610.24	7,370.47	96.85%

注：上表回款统计的截止日为 2022 年 2 月 28 日。

由上表可知，逾期应收账款的期后回款情况较好。公司部分客户在实际结算货款的过程中，存在付款流程较长而发生逾期的情况，该类客户均为行业内知名客户，与公司合作情况良好，信用度较高，相关逾期款项期后回款情况良好。此外，也存在一部分资金较为紧张的客户发生逾期情况。公司对于逾期货款已采用如电话、邮件、发函等多种形式积极催收，且每年末根据坏账准备计提政策计提坏账准备。

报告期各期末，公司应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

时间	应收账款余额	期后回款金额	期后回款比例
2021-9-30	60,833.44	29,916.37	49.18%
2020-12-31	47,193.62	38,821.82	82.26%
2019-12-31	29,679.31	28,098.27	94.67%
2018-12-31	22,338.98	21,910.72	98.08%

注：上表回款统计的截止日为 2022 年 2 月 28 日。

由上表可知，发行人应收账款期后回款正常，截至2022年2月28日，报告期末应收账款已回款49.18%。

报告期各期末，公司对应收账款按账龄分析法计提坏账准备。报告期各期末，公司应收账款余额中账龄在 1 年以内的金额占比分别为 78.92%、85.07%、85.55% 和 88.75%，报告期末 1 年以内账龄的应收账款占比较高。

报告期内，公司应收账款坏账准备金额分别为 1,731.46 万元、2,253.42 万元、2,839.75 万元和 3,848.31 万元，坏账准备计提充足。

公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例对比情况：

账龄	深科达	联得装备	易天股份	智云股份	正业科技
1年以内	5%	3%	5%	1%	3%
1至2年	10%	10%	15%	10%	5%
2至3年	30%	30%	30%	50%	10%
3至4年	50%	50%	50%	100%	30%
4至5年	80%	80%	80%	100%	50%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

注：可比公司的数据来自于公开披露的信息文件。

各可比公司由于客户群体和自身实际情况的不同，选用的坏账准备计提政策略有差异，但整体上差异较小。公司的坏账计提政策合理，符合谨慎性原则。

公司应收账款周转率与同行业可比公司比较情况如下：

公司简称	2021年1-9月	2020年度
联得装备	1.39	2.22
易天股份	1.58	2.28
智云股份	0.80	2.07
正业科技	1.44	1.40
平均值	1.30	1.99
深科达	1.41	1.89

数据来源：根据各可比公司公开披露的信息计算所得，其中2021年三季度报告未披露余额，因此可比上市公司2021年1-9月采用应收账款账面价值计算；2021年1-9月的应收账款周转率未作年化处理。

由上表可知，公司应收账款周转率与可比公司平均水平差异较小。

公司客户主要为大型显示面板、模组生产和半导体封测企业，应收账款无法收回的风险较小。报告期内，公司不存在因客户破产、经营困难而发生应收账款重大损失的情况，公司应收账款坏账准备计提充分。

公司已在募集说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”之“（三）发行人的其他风险”之“2、应收账款金额较高的风险”以及“第三节 风险因素”之“三、财务风险”之“（二）应收账款金额较高的风险”对应收账款占各期营业收入的比重较高等情况进行了风险提示。

二、2021年三季度末无订单商品的试用及销售情况，存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值的原因及合理性，进一步论证计提是否充分

（一）2021年三季度末无订单商品的试用及销售情况

类别	2021-9-30	
	金额(万元)	占比
无订单库存商品余额	2,192.96	100.00%
其中：期末属于试用产品	1,146.53	52.28%
期后已经销售	452.49	20.63%
期后未销售但已有订单覆盖	64.30	2.93%

注：上表销售及订单覆盖统计的截止日为2022年2月28日。

公司2021年9月末的库存商品余额为6,666.77万元，其中当时无订单金额2,192.96万元，期末库存商品的订单覆盖率为67.11%。截至2022年2月28日，上述无订单的库存商品已经销售452.49万元，未销售但已签订单的金额为64.30万元，两者合计516.79万元。

(二)存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值的原因及合理性，进一步论证计提是否充分

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为9.54%、3.06%、1.97%、1.37%，呈现下降趋势，主要系由于存货管理的持续优化带来的存货结构的改善，具体论证如下：

1、2018年起采取了更加稳健的生产和销售策略

公司2018年公司存货跌价准备余额较大，主要是2016-2017年期间，公司基于对市场发展和客户需求的预判，提前进行部分设备的生产，更快地响应客户需求，在部分业务机会中抢占先机，但同时也导致有少量设备投产后却未能如期实现销售的情况，公司于2018年对上述设备计提了较大比例的减值准备，同时亦自2018年起采取了更加稳健的生产和销售策略。

2、公司存货跌价准备计提方法较为谨慎

公司在资产负债表日，对各类存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

对于有订单支持的库存商品、发出商品、在产品，公司以销售价格减去（至完工时估计将要发生的成本及）估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

公司期末不存在无订单支持的发出商品。对于期末无订单对应的库存商品，库龄在1年以内的，公司参照近期同类产品销售价格减去估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；库龄在1年以上的，公司通过向供应商对该产品包含的材料的询价确认其可变现净值，直接人工、制造费用全额确认存货跌价准备。

对于无订单对应的在产品，库龄在1年以内的，公司以生产经营过程中所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；库龄在1年以上的，公司通过向供应商对包含的材料的询价确认其可变现净值，直接人工、制造费用全额确认存货跌价准备。

期末原材料的存货跌价准备计提方法：对于报告期期末相近3个月内发生采购交易的材料，公司采用近期均价确认其可变现净值。除前述以外的材料，公司通过向供应商对材料的询价确认其可变现净值。

3、公司存货库龄结构、存货周转率及存货占总资产的比例等方面近年来进一步改善、优化

报告期各期末，发行人存货库龄分布及减值准备计提情况如下表：

单位：万元

项目	2021-9-30				2020-12-31			
	余额	占比	跌价准备	计提比例	余额	占比	跌价准备	计提比例
1年以内	27,061.58	90.59%	114.19	0.42%	21,970.37	87.29%	99.88	0.45%
1-2年	1,584.46	5.30%	91.84	5.80%	2,039.80	8.10%	191.86	9.41%
2年以上	1,225.51	4.10%	204.29	16.67%	1,159.37	4.61%	203.05	17.51%
合计	29,871.55	100.00%	410.32	1.37%	25,169.53	100.00%	494.79	1.97%

续上表：

项目	2019-12-31				2018-12-31			
	余额	占比	跌价准备	计提比例	余额	占比	跌价准备	计提比例
1年以内	12,689.04	78.63%	36.40	0.29%	11,465.98	65.93%	21.06	0.18%
1-2年	2,180.13	13.51%	133.53	6.12%	1,288.78	7.41%	278.20	21.59%
2年以上	1,269.00	7.86%	323.69	25.51%	4,635.72	26.66%	1,359.75	29.33%
合计	16,138.18	100.00%	493.61	3.06%	17,390.47	100.00%	1,659.01	9.54%

公司存货跌价准备计提比例呈现下降趋势，一方面是2018年公司对部分提前生产的设备计提了较大比例的减值准备，导致2018年度的存货跌价准备金额较高；另一方面，公司持续提升存货管理水平，存货库龄结构、存货周转率等方面进一步改善、优化。

根据部分同行业可比公司公开披露的存货库龄信息，正业科技 2020 年末原材料和库存商品一年以上库龄占比分别为 33.87%和 66.31%（根据正业科技子公司集银科技数据计算，集银科技的产品和业务与公司较为接近）；联得装备 2018 年末和 2019 年末一年以上的存货占比分别为 17.71%、19.44%；智云股份 2019 年末库存商品一年以上库龄的存货占比高达 53.27%。公司报告期内一年以上库龄的存货余额占比分别为 34.07%、21.37%、10.24%和 9.41%，长库龄的存货占比呈下降趋势。

从可比公司上述公开披露的库龄信息看，同行业可比公司的库龄通常比公司存货库龄长，考虑到长库龄存货订单覆盖率较低，相应计提的存货跌价准备也较多。

报告期各期，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比上市公司的情况如下：

公司名称	2021-6-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
联得装备	1.93%	2.23%	1.56%	1.64%
易天股份	1.53%	1.32%	1.61%	1.39%
智云股份	24.00%	29.62%	29.88%	3.14%
正业科技	17.63%	31.66%	26.25%	4.52%
可比公司平均值	11.27%	16.21%	14.83%	2.67%
深科达	1.28%	1.97%	3.06%	9.54%

注：根据各可比公司公开披露的信息计算所得，其中 2021 年三季度报告未披露存货余额及跌价准备金额，因此采用 2021 年半年报数据。

如上表，公司 2019 年以来各期末的存货跌价准备计提比例低于可比上市公司平均值，主要原因是智云股份、正业科技的计提比例较大，其无订单、销售可能性较低的产品金额较大并计提了跌价准备，拉高了平均值。

报告期各期，公司存货周转率与同行业可比上市公司的情况如下：

公司名称	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
联得装备	1.15	1.42	1.21	1.49
易天股份	0.39	0.81	1.00	0.99
智云股份	0.65	1.89	0.46	1.45
正业科技	2.31	2.35	1.49	2.08
可比公司平均值	1.13	1.62	1.04	1.50
深科达	1.79	1.97	1.87	2.07

数据来源：各可比公司公开披露的信息计算所得。

报告期各期，公司与同行业可比上市公司存货余额占总资产的比例情况如下：

公司名称	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
联得装备	20.00%	23.21%	26.79%	30.74%
易天股份	34.02%	27.54%	24.36%	39.05%
智云股份	23.78%	28.05%	35.64%	16.53%
正业科技	16.14%	20.53%	23.31%	13.87%
可比公司平均值	23.49%	24.83%	27.52%	25.05%
深科达	20.45%	23.07%	22.74%	28.19%

注：可比公司数据根据其公开披露的信息计算所得，其中2021年三季度报告未披露存货余额，因此可比公司2021年第三季度末的比例采用存货账面价值计算，深科达采用存货余额计算。

由以上表格可以看出，最近两年一期，公司存货周转率总体比较稳定，且存货周转率高于同行业可比公司，此外，公司存货余额占总资产的比例亦低于同行业可比公司的平均值，公司存货周转情况、存货管理水平良好。

综上，公司存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值具有合理性，主要系由于存货管理的持续优化带来的存货结构的改善，公司存货跌价准备计提方法较为谨慎，符合公司生产经营的实际情况，公司存货跌价准备计提充足。

公司已在募集说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”之“（三）发行人的其他风险”之“3、存货管理风险”以及“第三节 风险因素”之“三、财务风险”之“（三）存货管理风险”对存货价值较大的情况进行了风险提示。

三、结合公司业务规模扩大情况，分析公司销售人员人数及劳务外包支出同时大幅增长的合理性

最近一年及一期，公司营业收入、销售人员人数及劳务外包费的变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	变动比例	2020年度
营业收入	71,104.23	9.72%	64,802.32
销售人员（人）	376	35.25%	278
销售费用-劳务外包费	825.79	423.85%	157.64

注：销售人员人数按当期各月销售人员人数加总/月份数计算取整得出

公司 2021 年 1-9 月营业收入、销售人员人数以及计入销售费用的劳务外包费分别较上年增长 9.72%、35.25%、423.85%。由于公司销售具有季节性特点，下半年特别是第四季度的收入占比通常较高。根据公司披露的 2021 年年度业绩快报，公司 2021 年度实现的营业收入为 91,124.63 万元，较上年增长 40.62%，2021 年前三季度的销售人员平均人数较上年增长 35.25%，营业收入与 2021 年前三季度的销售人员人数的增长比例相匹配。

销售费用中的劳务外包费增长 423.85%，增长幅度较大。销售费用中的劳务外包主要为满足售后服务的需要，费用支出受产品交付地点和疫情的影响。2021 年 1-9 月收入规模增长需要较多的售后维护服务，且之前年度已经完成的部分销售也需要持续的售后服务，劳务外包支出增长较快，主要如下：

1、报告期各期，公司主营业务收入的外销收入金额分别为 623.63 万元、56.43 万元、3,126.92 万元和 1,052.84 万元。外销收入主要来自台湾地区，因为疫情原因，公司员工无法抵达台湾当地对客户进行售后服务，因此在当地聘请符合条件的公司协助进行售后服务，其中 2021 年 1-9 月因对友达光电、群创光电等客户进行售后服务发生支出合计 244.22 万元。

2、报告期各期，国内销售业务也大幅增长。受疫情影响，公司员工在进行疫情管控的期间难以在当地及时开展工作，同时业务规模的增长使得售后服务的工作量亦有所加大，因此公司在境内因聘请符合条件的公司协助进行售后服务，而产生的支出亦增长较快。

综上，销售人员人数及劳务外包支出大幅增长，与公司营业收入增长的趋势相匹配，符合公司的业务实际，具有合理性。

四、原材料市场价及采购价的变动情况是否一致，毛利率下降趋势是否持续，是否对公司经营构成重大不利影响，本次募投项目建成后对公司毛利率的影响

（一）原材料市场价及采购价的变动情况是否一致

公司采购的原材料主要包含电气元件、机械元件、机加钣金件、外购定制件和辅料等，具体如下：

类别	物料名称
电气元件	直线电机、开关电源、PLC、气缸、电磁阀类、光源控制器、工控机、工业相机、视觉控制系统、读码器、加密狗等
机械元件	伺服电机、机械手、减速机、UVW 平台、丝杆、滚珠花键、导轨、PSM、USC 等

类别	物料名称
机加钣金件	机加件、钣金件、方通、型材、管材等
外购定制件	功能模块设备、治具类、模具、压头等
辅料	电缆线、扎带、线槽、螺丝、风扇、轴承、O型圈、合页、端子、接线排等

2020年和2021年1-9月，主要大宗商品期货日均结算价如下：

大宗商品名称	2021年1-9月		2020年度
	期货结算价（日均）	变动	期货结算价（日均）
不锈钢期货（万元/吨）	1.62	19.65%	1.35
铝期货（万元/吨）	1.85	32.29%	1.40
铁矿石期货（元/吨）	1,032.47	36.58%	755.94
铜期货（万元/吨）	6.76	38.77%	4.87

注：上表数据来源于同花顺 iFinD，其中不锈钢期货、铝期货和铜期货均为上海期货交易所的结算价，铁矿石期货为大连商品交易所的结算价。

2021年，铜、铁、铝等大宗商品价格普遍上涨，芯片供求关系较为紧张、产能不足也导致芯片的价格大幅上涨，传导到下游电气元件、机械元件、机加钣金件等行业，导致电气元件、机械元件、机加钣金件等原材料价格上涨。

2021年1-9月，公司电气元件、机械元件平均采购单价较2020年度分别上涨56.12%和11.88%，机加钣金件平均采购单价较上年度上涨11.40%（其中，深科达上涨27.87%，深科达微电子上涨21.81%，深科达半导体上涨6.72%，线马科技因采购的机加钣金件价小量大、不具有可比性而未纳入统计范围）。此外，外购定制件和辅料的平均采购单价也较上年上涨。

以下表的原材料为例，公司原材料2021年度较2020年度的平均采购单价与市场价格的变动情况如下：

序号	采购类别	品名	规格	公司采购单价变动	市场价格变动
1	辅料	电缆线(通用件)	3芯线_0.3m m ² _黑色	29.3%	23.69%
2	辅料	电缆线(通用件)	3芯线_2.5m m ² _黑色	21.1%	15.81%
3	辅料	电缆线(通用件)	4芯线_0.3m m ² _黑色	36.8%	30.89%
4	辅料	电缆线(通用件)	6芯线_0.3m m ² _黑色	29.9%	24.29%
5	辅料	电缆线(通用件)	8芯线_0.3m m ² _黑色	27.7%	22.13%
6	辅料	电线(通用件)	1芯线_25m m ² _红色	81.9%	74.01%
7	辅料	电线(通用件)	1芯线_25m m ² _蓝色	84.0%	76.01%
8	辅料	电线(通用件)	1芯线_1.5m m ² _蓝色	47.1%	40.68%
9	辅料	电线(通用件)	1芯线_1.5m m ² _红色	36.2%	30.27%

序号	采购类别	品名	规格	公司采购 单价变动	市场价 格变动
10	辅料	电线(通用件)	1 芯线_2.5m m ² _红色	49.4%	42.94%
11	电气元件	漏电断路器_施耐德	IC65N-D6A/2P VE30MA	5.3%	3.25%
12	电气元件	漏电断路器_施耐德	IC65N-D10A/3P VE30MA	9.0%	6.88%
13	电气元件	漏电断路器_施耐德	IC65N-D16A/2P VE30MA	6.3%	4.23%
14	电气元件	漏电断路器_施耐德	IC65N-D32A-3P VE100MA	3.7%	1.77%
15	电气元件	塑壳式漏电断路器_施耐德	EZD160M-3p_80A_EL(0.1-0.3-0.5-1A 可调)	5.9%	3.89%
16	电气元件	塑壳式漏电断路器_施耐德	EZD160M-3p_125A_EL(0.1-0.3-0.5-1A 可调)	2.5%	0.59%
17	电气元件	塑壳式漏电断路器_施耐德	EZD160M-3p_160A_EL(0.1-0.3-0.5-1A 可调)	3.7%	1.72%
18	外购定制件	滚珠丝杆 HIWIN	SKDR030094-R20-20K2-FSC-640-750-0.012	7.4%	2.50%
19	外购定制件	滚珠丝杆 HIWIN	SKDR030095-R20-20K2-FSC-440-550-0.012	8.0%	3.06%
20	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030483-SFURL1610-DGC5-380-P1	5.0%	1.18%
21	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030373-SFV03220-2.7-DGC5-1530-P2&75 分贝以下	6.7%	2.84%
22	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030324-SFHR03232-DGC5-1860-P2-SS/75 分贝以下	10.0%	6.02%
23	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030226-SFS04020-2.8-DGC5-420-P0/75 分贝以下	10.0%	6.00%
24	外购定制件	滚珠丝杆_TBI	SKDR030374-SFS04020-2.8-DGC5-490-P0&75 分贝以下	6.7%	2.79%
25	外购定制件	滚珠丝杆 HIWIN	SKDR030094-R20-20K2-FSC-640-750-0.012	10.1%	5.08%
26	外购定制件	滚珠丝杆 HIWIN	SKDR030095-R20-20K2-FSC-440-550-0.012	8.5%	3.58%
27	外购定制件	滚珠丝杆 HIWIN	SKDR030390-4R25-25S2-DFSH-1170-1300-0.05	20.4%	14.91%
28	机械元件	滑块_HIWIN	HGH20CA	37.8%	31.54%
29	机械元件	导轨_HIWIN	HGR20R4000C	34.4%	28.32%
30	机械元件	导轨_HIWIN	MGN12C1R60Z0C E1=E2=5/75 分贝以下	23.6%	17.96%
31	机械元件	滑块_HIWIN	MGN9CZ0C	15.9%	10.59%
32	机械元件	导轨_HIWIN	MGN9R2000C	18.3%	12.92%
33	机械元件	滑块_HIWIN	HGL15CA	38.0%	31.69%
34	机械元件	导轨_HIWIN	MGN15C1R110Z0C E1=15 E2=15	26.5%	20.74%
35	机械元件	导轨_HIWIN	HGR15R4000C	41.5%	35.07%
36	机械元件	滑块_HIWIN	HGH20CA	29.1%	23.23%
37	机械元件	导轨_HIWIN	HGR20R4000C	25.4%	19.69%
38	机加钣金件	铝(国产)	/	32.8%	27.01%
39	机加钣金件	铝(进口)	/	18.7%	13.53%
40	机加钣金件	钢板	/	376.9%	356.12%

序号	采购类别	品名	规格	公司采购单价变动	市场价格变动
41	机加钣金件	铜	/	84.8%	76.76%
42	机加钣金件	JLD0100-752103A0 升降板-喷砂氧化	6061 1.674/0.111	215.7%	201.97%
43	机加钣金件	JLD0100-752104A0 加强筋 2-喷砂氧化	6061 0.601/0.055	212.8%	199.21%
44	机加钣金件	JLD0100-521101A0 侧板-喷砂氧化	6061 1.262/0.087	217.0%	203.26%
45	机加钣金件	JLD0100-521102A0 侧板 2-喷砂氧化	6061 2.524/0.174	217.8%	203.94%
46	机加钣金件	JLD0100-521301A0 支撑板-喷砂氧化	6061 1.668/0.132	194.2%	181.45%

注：上表市场价格变动来自公司供应商数据；因公司原材料采购种类繁多，仅以上表为例说明采购价与市场价的变动对比。

由上表可知，公司原材料平均采购单价的波动与市场价波动趋势一致。

公司原材料采购种类繁多，且由于非标准化产品的要求存在差异，不同原材料零部件的形状、规格、大小、工艺等存在较大差别。公司建立了较为严格和完善的供应商筛选制度，多渠道、多途径筛选合格供应商，并对合格供应商名单进行动态化管理。从原材料品质、价格、交货期和服务以及供应商资质、规模、品牌等多个方面对于供应商进行评审和考核，建立合格供应商名录，确保原材料的质量和供应的稳定。同时，在采购价格方面，公司对主要原材料通常按照“同一材料，多家询价”的方式在采购时进行询价，实时了解原材料的价格行情，采购价格具有公允性，与市场价格一致。

综上，公司原材料平均采购价格上涨，与市场价格的变动趋势一致。

（二）毛利率下降趋势是否持续，是否对公司经营构成重大不利影响

公司 2021 年度综合毛利率为 33.06%，较上年的 38.65% 下降了 5.59 个百分点。公司预计未来毛利率下降趋势不会持续，毛利率将趋于稳定，主要原因包括：1、随着未来全球疫情对各国复工复产的影响日益降低，上游大宗商品、原材料等的因短期供求关系带来的巨幅波动终将恢复正常、回归理性，长期来看，公司原材料采购价格预计将恢复正常水平；2、深科达半导体与其核心零部件供应商达成了长期合作，预计零部件采购价格较为稳定，同时由于半导体设备产品逐渐打开市

场，获得了客户的认可，产品销售均价也较为稳定，因此公司半导体设备产品的毛利率较为稳定，随着半导体设备收入金额和占比的上升，对公司整体毛利率具有较强的稳定作用；3、未来随着公司募投项目的陆续投产，公司将进一步提高技术水平和持续盈利能力，且对部分毛利率低的订单具有更高的选择权，对公司整体毛利率具有提升作用。

综上，公司预计未来毛利率下降趋势不会持续，毛利率将趋于稳定，对公司经营不存在重大不利影响。

（三）本次募投项目建成后对公司毛利率的影响

报告期内，公司主营业务分产品类别的毛利率情况如下：

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
平板显示模组设备	28.82%	-10.93%	39.75%	3.15%	36.60%	-1.15%	37.76%
半导体设备	32.88%	3.14%	29.74%	1.26%	28.48%	-5.61%	34.09%
直线电机	45.74%	-1.62%	47.36%	5.70%	41.66%	0.36%	41.31%
摄像模组类设备	28.49%	-11.76%	40.25%	-23.98%	64.23%	-	-
其他	36.87%	-2.60%	39.47%	11.40%	28.07%	2.51%	25.56%
主营业务毛利率	31.48%	-6.94%	38.42%	0.65%	37.77%	0.29%	37.48%
综合毛利率	31.71%	-6.94%	38.65%	0.76%	37.89%	0.29%	37.60%

报告期内，公司主营业务毛利率分别 37.48%、37.77%、38.42%和 31.48%，由于产品结构变化、原材料采购成本上涨、市场竞争加剧以及 OEM 采购占比上升等因素的影响，导致公司平板显示设备毛利率下降，对公司盈利水平构成一定的不利影响。

未来随着公司募投项目的陆续投产，公司将进一步提高技术水平和持续盈利能力。本次募投项目具体主要包括惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目、半导体先进封装测试设备研发及生产项目和平板显示器件自动化专业设备生产建设项目。

根据公司初步测算，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目建成后，毛利率测算情况如下：

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10
毛利率	34.16%	35.99%	36.57%	36.57%	36.57%	37.27%	37.27%	37.27%	37.27%	37.27%

半导体先进封装测试设备研发及生产项目建成后，毛利率测算情况如下：

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10
毛利率	31.51%	33.06%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%	33.57%

平板显示器件自动化专业设备生产建设项目建成后，毛利率测算情况如下：

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10
毛利率	37.04%	37.47%	37.76%	38.25%	38.20%	38.20%	38.15%	38.15%	38.09%	38.09%

公司 2020 年和 2021 年 1-9 月的综合毛利率分别为 38.65%和 31.71%，由以上表格测算，公司以上三个募投项目建成投产后第一年的毛利率(T+1)分别为 34.16%、31.51%、37.04%，虽然与公司 2020 年的综合毛利率 38.65%相比偏低，但考虑到 1) 惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目和平板显示器件自动化专业设备生产建设项目的毛利率均高于公司 2021 年 1-9 月的综合毛利率 31.71%；2) 半导体先进封装测试设备研发及生产项目投产后第一年（T+1）的毛利率与公司 2021 年 1-9 月的综合毛利率持平，且预计随着募投项目的成熟运行，募投项目的毛利率将比投产第一年有所提升并逐渐稳定，因此本次募投项目建成后对公司产品毛利率具有提升和稳定作用。

公司已在募集说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”之“（三）发行人的其他风险”之“1、原材料价格波动对发行人业绩影响较大的风险”以及“第三节 风险因素”之“三、财务风险”之“（一）原材料价格波动对发行人业绩影响较大的风险”对原材料价格波动影响公司业绩进行了风险提示。

五、2021 年营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配的原因及合理性，公司生产经营是否出现重大不利变化

根据公司披露的 2021 年年度业绩快报，2021 年度收入增长 40.62%，归属于母公司所有者的净利润下滑 21.21%，营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配。

公司 2021 年度营业收入较去年增长 26,322.31 万元，增长率为 40.62%，归属于母公司所有者的净利润下滑 21.21%，主要原因是公司平板显示设备毛利率较去年下降 8.49 个百分点，销售费用较去年增长 4,387.49 万元，增长率为 63.52%，营业收入的增长幅度低于销售费用的增长幅度。其中，平板显示设备毛利率下降的主要原因是平板显示设备产品结构变化、原材料采购成本上涨、市场竞争加剧以

及 OEM 采购占比上升等因素影响。销售费用增加的主要原因：1、公司业务规模扩大，销售人员增加导致职工薪酬支出增加；2、受产品交付地点和疫情的影响，为满足售后服务的需要，公司聘请符合条件的公司协助进行售后服务，导致售后服务费用支出大幅增加。上述具体情况参见公司《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》之“6.关于经营情况”。

根据公开披露的信息，公司与可比上市公司 2021 年度营业收入及归属于母公司所有者的净利润情况如下：

公司名称	营业收入及利润情况
联得装备	根据三季度报告，收入同步增长 20.02%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 58.44%；根据业绩预告，2021 年度盈利 2,000 万元-2,500 万元，2020 年度盈利 7,429.04 万元，比上年同期下降 73.08%-66.35%
易天股份	根据三季度报告，收入同步增长 10.39%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 18.73%
智云股份	根据业绩预告，归属于母公司所有者的净利润 2021 年度亏损 55,000 万元-80,000 万元，2020 年度盈利 3,623.74 万元
正业科技	根据业绩预告，归属于母公司所有者的净利润 2021 年度盈利 13,000 万元 - 14,500 万元，2020 年度亏损 31,309.60 万元，
深科达	根据业绩快报，2021 年度收入增长 40.62%，归属于母公司所有者的净利润下滑 21.21%

由上表可知，联得装备、智云股份的利润下滑幅度较大，下滑程度高于公司。正业科技利润增长幅度较大，主要是工业检测设备产品的市场行情向好，尤其是锂电检测自动化板块市场需求大增，全年接单金额超过 6 亿元，2021 年锂电检测自动化业务全年接单金额较 2020 年全年接单金额同比增长超过 30%，此外，正业科技 2021 年度处置了位于广东省东莞市松山湖的房产，该事项增加 2021 年度归属于母公司所有者的净利润约 9,739.60 万元，属于非经常性损益项目，正业科技扣除非经常性损益后的净利润约盈利 1,000 万元-1,450 万元。因此，与同行业可比公司相比，公司盈利水平良好。

报告期内，公司主营业务、经营模式、生产模式，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。另一方面，由于产品结构变化、原材料采购成本上涨、市场竞争加剧以及 OEM 采购占比上升等因素的影响，导致公司平板显示设备毛利率下降，对公司盈利水平构成一定的不利影响。整体而言，公司生产经营不存在重大不利变化。

综上，公司 2021 年营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配具有合理性，符合公司生产经营实际，公司生产经营不存在重大不利变化，与同

行业可比公司相比，公司盈利水平良好。

六、申报会计师的核查程序和核查意见

（一）核查程序

申报会计师履行了以下主要核查程序：

1、获取发行人的应收账款、营业收入明细表，分析应收账款占营业收入比重大幅增长的原因及合理性；

2、获取发行人的应收账款逾期统计表，分析其与发行人信用政策的匹配性；

3、检查应收账款、逾期应收账款的期后回款情况，分析其是否存在重大坏账风险；

4、查阅同行业可比公司公开披露的信息，对比分析同行业可比公司应收账款占营业收入比重的变动、应收账款坏账准备计提比例对比、应收账款周转率等情况；

5、核查 2021 年三季度末无订单商品的试用及期后销售情况；

6、复核存货跌价准备计提情况，核实跌价准备是否计提充分；

7、查阅同行业可比公司公开披露的信息，对比分析同行业可比公司存货跌价准备计提比例、存货周转率、存货余额占总资产的比例等情况；

8、核查发行人最近一期销售人员增长和劳务外包情况，对管理层进行访谈并了解销售人员人数及劳务外包支出大幅增长的原因，分析其合理性；

9、查阅网络公开信息，了解上游大宗商品、芯片及电气元件、机械元件等原材料的市场价格波动情况；

10、获取采购明细表，了解并分析发行人原材料采购价格的变动情况；

11、对管理层进行访谈，了解毛利率下降的原因及对经营管理产生的影响；

12、获取募投项目毛利率测算表，分析募投项目投产后对产品毛利率的影响；

13、查阅同行业可比公司公开披露的信息，对比分析同行业可比公司 2021 年度的营业收入和利润变化情况。

（二）核查结论

经核查，申报会计师认为：

1、发行人信用政策未发生重大变化但应收账款占营业收入比重大幅增长的原因具有合理性，发行人不存在重大坏账风险；

2、发行人 2021 年三季度末无订单商品的试用及销售情况符合生产经营实际，存货跌价准备计提比例逐步下降且低于可比上市公司平均值的原因具有合理性，存货跌价准备计提充分；

3、发行人销售人员人数及劳务外包支出同时大幅增长的原因具有合理性；

4、原材料市场价与发行人原材料采购价的变动趋势一致，发行人毛利率下降趋势预计不持续，对发行人经营不构成重大不利影响，本次募投项目建成后对发行人毛利率具有提升和稳定作用；

5、发行人 2021 年营业收入与归属于母公司所有者的净利润变动情况不匹配的原因具有合理性，发行人生产经营不存在重大不利变化。

专此说明，请予察核。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



杨谦

中国注册会计师：



李民聪

二〇二二年三月二十四日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 负责人 梁春, 杨建文
 经营范围 会计师事务所(普通合伙) 特殊普通合伙

成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至长期
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年12月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

说明

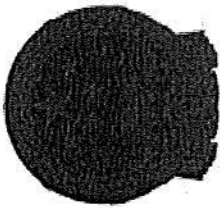
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法准予注册注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或不予注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所执业证书
已作废旧用
不得用于业务
报告
如有冒用
后果自负



发证机关: 北京市财政局
二〇一七年 十一月 十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

姓名 杨谦
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1979-09-15
Date of birth

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit

身份证号码 430104790915151
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



杨谦
430100210044
深圳市注册会计师协会

年. ter

日 /d

9



证书编号: 430100210044
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 11 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

4

姓名 Full name 李民聪
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-01-24
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 360782198801243813



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



李民聪
 110101480762
 深圳市注册会计师协会

日/d

5

证书编号: 110101480762
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 07 月 28 日
 Date of Issuance /y /m /d